

高出力ファイバ結合型 青色半導体レーザー

波長：450nm

金 (Au)や銅 (Cu)などの金属材料の光吸収率が高く、材料ダメージ軽減、高効率な加工を実現

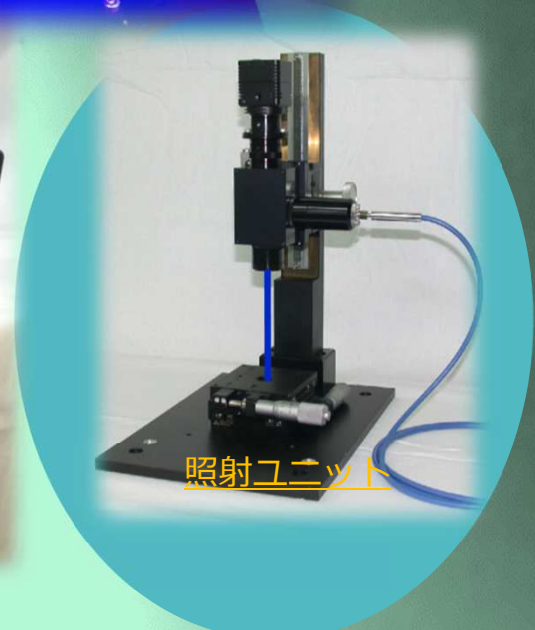
出力：

20W / 50W / 100W

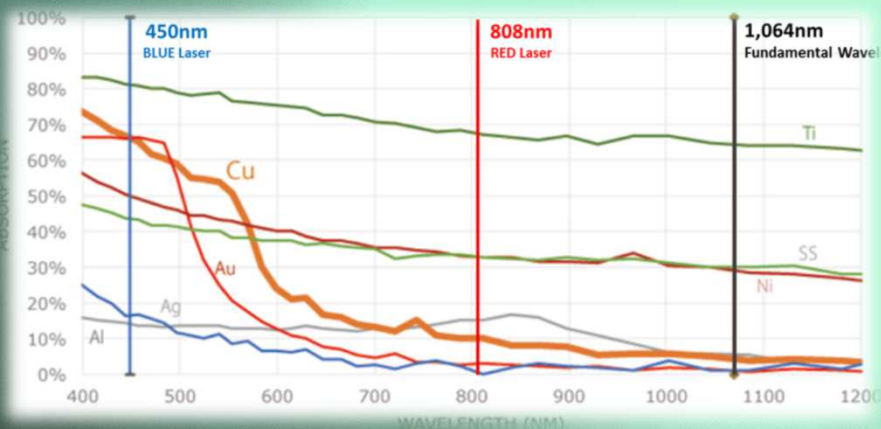
高出力、高効率LDモジュールにより高速加工が可能

光ファイバ径：100 μ m

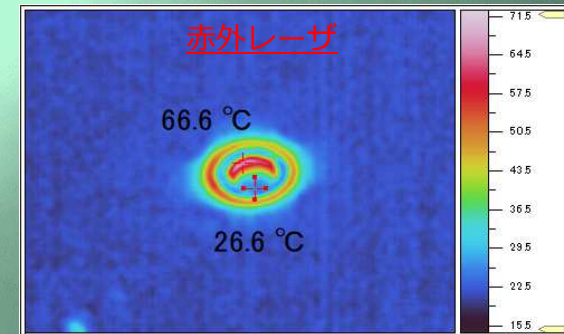
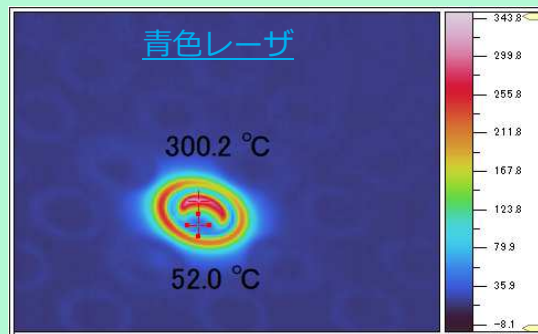
光ファイバコア径100 μ m採用により微細加工に最適



金属材料と光吸収率



◆金 (Au)メッキスルーホール基板へのレーザー照射 (Blue VS IR)
ビーム径 ϕ 200 μ m、出力1Wでの表面温度測定



* 赤外線サーモグラフィ-FSV-2000提供：株式会社アピステ